

Giovedì 19 Dicembre 2024
Notizie mercati esteri [1]

Singapore. Approvata misura d'aiuto dallo Stato italiano da 1,3 miliardi di euro per sostenere l'azienda Silicon Box

La Commissione Europea ha approvato, ai sensi delle norme UE sugli aiuti di Stato, una misura italiana da 1,3 miliardi di euro per sostenere Silicon Box nella costruzione di un impianto avanzato di packaging e testing di semiconduttori a Novara. La misura rafforzerà la sicurezza dell'approvvigionamento, la resilienza e l'autonomia tecnologica dell'Europa nel settore dei semiconduttori, in linea con gli obiettivi definiti nella Comunicazione sul Chips Act Europeo e nelle Linee Guida Politiche della Commissione Europea 2024-2029.

La misura italiana

L'Italia ha notificato alla Commissione il proprio piano per sostenere il progetto di Silicon Box volto alla realizzazione di un nuovo impianto avanzato di packaging e testing di semiconduttori a Novara. Il packaging avanzato consente di integrare in un unico modulo più chip, spesso con funzioni diverse, creando un modulo multi-chip o un "chiplet". Questo approccio permette al chiplet di funzionare come un unico chip, migliorandone le prestazioni e l'efficienza energetica.

Il nuovo impianto offrirà soluzioni avanzate di packaging che integrano chiplet utilizzando tecniche di packaging a livello di pannello anziché a livello di wafer, insieme a tecnologie di integrazione 3D. La struttura gestirà fasi chiave della produzione, come assemblaggio, packaging e testing dei chip. L'impianto, che dovrebbe raggiungere la piena operatività entro il 2033, sarà in grado di processare circa 10.000 pannelli a settimana.

Il sostegno si concretizzerà sotto forma di una sovvenzione diretta di circa 1,3 miliardi di euro a Silicon Box per supportare un investimento complessivo di 3,2 miliardi di euro. Nell'ambito della misura, Silicon Box si è impegnata a:

- Garantire che il progetto abbia un impatto più ampio con effetti positivi sulla catena del valore dei semiconduttori nell'UE.
- Contribuire allo sviluppo della prossima generazione di tecnologie avanzate di packaging nell'UE.
- Implementare ordini prioritari in caso di carenza di approvvigionamento, in linea con il Chips Act Europeo.
- Sviluppare e attuare programmi di formazione per aumentare la disponibilità di una forza lavoro qualificata.

La valutazione della Commissione

La Commissione ha valutato la misura italiana ai sensi delle norme UE sugli aiuti di Stato, in particolare dell'Articolo 107(3)(c) del Trattato sul Funzionamento dell'UE (TFUE), che consente agli Stati membri di concedere aiuti per lo sviluppo di determinate attività economiche a determinate condizioni, e basandosi sui principi stabiliti nella Comunicazione sul Chips Act Europeo.

La Commissione ha rilevato che:

- La misura favorisce lo sviluppo di determinate attività economiche, consentendo la creazione di un nuovo impianto avanzato di packaging in Europa con tecnologie innovative.
- L'impianto è il primo del suo genere in Europa, in quanto attualmente non esiste una struttura di packaging avanzato comparabile con le caratteristiche tecnologiche specifiche.
- L'aiuto ha un "effetto incentivante", poiché il beneficiario non avrebbe effettuato questo investimento in Europa senza il sostegno pubblico.
- La misura ha un impatto limitato sulla concorrenza e sul commercio all'interno dell'UE. È necessaria e appropriata per garantire la resilienza della catena di approvvigionamento europea dei semiconduttori. Inoltre, l'aiuto è proporzionato e limitato al minimo necessario, basandosi su un comprovato gap di finanziamento.

La misura avrà effetti positivi per l'ecosistema europeo dei semiconduttori, contribuendo a rafforzare la sicurezza dell'approvvigionamento, in particolare attraverso la creazione di un impianto avanzato di packaging che copre i passaggi produttivi rilevanti e l'impegno a rispettare gli ordini prioritari in caso di crisi, come definito nel Regolamento Chips Act.

Sulla base di queste considerazioni, la Commissione ha approvato la misura italiana ai sensi delle norme UE sugli aiuti di Stato.

Contesto

L'8 febbraio 2022, la Commissione ha adottato la Comunicazione sul Chips Act Europeo, parte di un pacchetto più ampio che include il Chips Act Europeo entrato in vigore il 21 settembre 2023.

Per ulteriori informazioni, la versione non riservata della decisione sarà disponibile con il numero di caso SA.113264 nel registro degli aiuti di Stato sul sito web della concorrenza della Commissione, una volta risolte eventuali questioni di riservatezza.

(Contributo editoriale a cura della Italian Chamber of Commerce in Singapore [2])
Ultima modifica: Lunedì 13 Gennaio 2025

Condividi

Reti Sociali

ARGOMENTI

Source URL: https://www.assocamerestero.it/notizie/singapore-approvata-misura-daiuto-dallo-stato-italiano-13-miliardi-euro-sostenere-lazienda

Collegamenti
[1] https://www.assocamerestero.it/notizie/%3Ffield_notizia_categoria_tid%3D1122

[2] https://www.assocamerestero.it/ccie/italian-chamber-of-commerce-singapore